证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-037

有研半导体硅材料股份公司 关于调整公司2024年股票期权激励计划 行权价格的公告

】292信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次 会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将具体调整事项说

- 本次股权激励计划已履行的审批程序

1,2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公 司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期 权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于《有研半导体硅材料股份公司2024年股 票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激 励计划实施差核管理办法>的议案》《关于核实。有研坐导体硅材料股份公司2024股票期权激励计 划首次授予部分激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核

2、2024年9月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股 份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少颖受其他独 立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行 了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公 司 2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-

4、2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<有研半导体硅材料股 份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年 股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授

予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 5、2024年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股 份公司关于2024年股票期权激励计划内墓信息知情人买卖公司股票情况的白杏报告》(公告编号, 2024-043)

6、2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关 于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予 条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145,00万份股票期权。上 述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对 象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com, en) 披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的公告》(公告编号:2024-047)及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部 分激励对象名单(截止授予日)》。

7、2024年10月24日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首 次授予完成登记的公告》(公告编号:2024-048),公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成授予登记手续,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8,2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通讨了《关于 向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予 预留部分期权的条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激 劢对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审 议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和 职务讲行了公示,公示期共10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提 出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于 公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日,公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公 告》,股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日,股票期权预留授予登记数量为90.00万份,股 票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年 股票期权激励计划行权价格的议案》、根据2024年第二次临时股东大会的授权对2024年股票期权激 励计划行权价格进行相应调整,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时,第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年 股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票 期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达 到目标值,公司层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权, 公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票 期权,本次实际可行权激励对象为92名,行权数量为268.08万份,行权价格为9.05元/股。薪酬和考核 委员会发表了明确同意的意见

二、本次股票期权激励计划行权价格的调整说明 (一)调整原因

2025年4月25日,公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的 议案》,同意向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1, 247,621,058股,扣除回购股份3,555,336股,以此计算本次拟派发现金红利74,643,943.32元(含税),占 2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股

具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导 体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计 划(草案)》的规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,若公司发生 派发股票红利的情况,股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

根据公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的期完 本激励计划公 告日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有派发股票红利的情况,应对股票期权行权价格进 行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下:

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍

二次临时股东大会授权对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整,经过本次调整后,行权 价格由9.11元/股调整为9.05元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不 会影响公司股票期权激励计划的继续实施。 四、董事会薪酬和考核委员会意见

公司董事令薪酬和老核委员会认为,本次调整符合《有研坐导体硅材料股份公司2024年股票期 权激励计划实施考核管理办法》以及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》 中关于股票期权行权价格调整的相关规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果 产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行

五、法律意见书的结论性意见 北京德恒律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司2024年股票期权激励计划调整行权 价格,首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权: 公司本次股票期权激励计划调整行权价格、本次行权条件的成就及本次注销符合《管理办法》《激励计 划(草案)》的相关规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续,并履行相应的信息披露义务。

有研半导体硅材料股份公司董事会 2025年10月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-034

有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2025年10月20日通过电子邮件形式送达全体董 事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生主持,公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》 公司拟将"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"中一部分资金11,922万元用于新建"集成电路用8 英寸硅片再扩产项目"。原"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"预定可使用状态日期由2025年12月延 期至2026年12月;新建项目预计完成时间为2026年12月。具体内容详见公司同日披露于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分

募投项目延期及新增募投项目的公告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提请公司股东会审议批准

(二)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》

为更好地发挥股权激励作用,确保公司长期发展目标的实现,公司结合相关法律法规的规定和实 际授予情况,进一步明确2024年股票期权激励计划预留部分公司业绩考核要求和个人层面绩效考核 要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股 份公司关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

(三)审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》规定,鉴于在本激励计划草 案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司发生派发股票红利的情况,股票期权的行权 价格将根据本激励计划做相应的调整。经本次调整后,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于 调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

(四)审议通过《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》

根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》相关规定,公司2024年息税 折旧摊销前利润(EBITDA)为4.11亿元,达到触发值但未达到目标值,公司层面可行权比例为80%。 根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,公司对股票 期权激励计划首次授予的92名激励对象进行了2024年度考核。其中,82名激励对象的年度绩效考核 结果为"A",10名激励对象的年度绩效考核结果为"B"。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。 (五)审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议

根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。2024年股票期 权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次 授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通讨。

(六)审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的

根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》相关规定,本激励计划首次 授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值,公司层面可行权比例为 80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权,公司及个人考核不达标部分的股票 期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。具体内容详见公司同日披露 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计 划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定、 公司编制了2025年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)的《有研半导体硅材料股份公司2025年第三季度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 (八)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币50,000万元(含本数)进行现金 管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股 份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 公司将于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于召开2025年第三次临时股东会 的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-036 有研半导体硅材料股份公司 关于2024年股票期权激励计划预留部分 考核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月27日,有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会 议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》。根据《有研半导体硅材料股 份公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划")的相关 规定和公司2024年第二次临时股东大会授权,董事会对公司2024年股票期权激励计划的预留部分考 核进行了明确,现将有关事项说明如下:

一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于《有研半导体硅材料股份公 司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期 权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于《有研半导体硅材料股份公司2024年股 票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于 < 有研半导体硅材料股份公司 2024年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<有研半导体硅材料股份公司2024股票期权激励计 划首次授予部分激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核

2、2024年9月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股 份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少颖受其他独 立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行 了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公 司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-

4、2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<有研半导体硅材料股 份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年 股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授 予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股 份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:

6、2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关 干向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为太激励计划的授予 条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上 述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对 象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.c cn)披露《有研坐导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的公告》(公告编号:2024-047)及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部 分激励对象名单(截止授予日)》。

7、2024年10月24日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首 次授予完成登记的公告》(公告编号:2024-048),公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成授予登记手续,向92名激励对象授予1,145,00万份股票期权。

8、2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励 预留部分期权的条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激 励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审 议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和 职务进行了公示,公示期共10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提 出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司临事会关于 公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日,公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公 告》,股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日,股票期权预留授予登记数量为90.00万份,股 票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年股票期权

激励计划预留部分考核的议案》,薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。 二、预留授予部分考核情况说明

(一)公司层面业绩考核要求

为更好地发挥股权激励作用,确保公司长期发展目标的实现,公司结合相关法律法规的规定和实 际授予情况,进一步明确预留部分公司业绩考核要求,具体如下:

本激励计划预留授予部分考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以公 司2024年(FRITDA)为基数 对差核年度的自稳折旧摊销前利润进行差核 根据上述指标的完成情况 核算久年度公司厚面的行权比例。本衡励计划授予的股票期权的行权安排及对应业绩差核目标加下

行权期	业绩考核 年度	(A)				
		目标值(Am)	触发值(An)			
预留授予部分 第一个行权期	2025年	4.5亿元	4亿元			
预留授予部分 第二个行权期	2026年	4.8亿元	4.2 亿元			
预留授予部分 第三个行权期	2027年	5.0亿元	4.4亿元			
预留授予部分的行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司						

当期业绩水平未达到下述业绩考核条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得

考核指标	业绩完成度	公司层面可行权比例X
	A≽Am	X=100%
2025年息税折旧摊销前利润	Am>A≥4.20	X=80%
EBITDA(A)	4.20>A≥An	X=50%
	An>A	X=0%
	A≽Am	X=100%
2026年息税折旧摊销前利润	Am>A≥4.40	X=80%
EBITDA(A)	4.40>A≥An	X=50%
	An>A	X=0%
	A≽Am	X=100%
2027年息税折旧摊销前利润	Am>A≥4.60	X=80%
EBITDA(A)	4.60>A≥An	X=50%
	An>A	X=0%

注1:上述"息税折旧摊销前利润EBITDA"以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据,且剔 除本次及考核期间内其它后续激励计划股份支付费用影响的数值:

注2:本激励计划涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核 结果确定其行权额度。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级 表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权额度:

激励对象个人当期可行权数量=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例(X)×个人层面行权

激励对象当期因考核原因不得行权的股票期权,作废失效,不可递延至以后年度,由公司统一安 排注销。

三、薪酬和考核委员会的意见

薪酬和考核委员会认为:本次公司进一步明确了预留部分股票期权行权的考核指标,有利于保障 本次激励计划的顺利实施,能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各 方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力,不存在明显损害上市公司 及全体股东利益的情形。 特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会 2025年10月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-038

关于2024年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期行权条件成就暨注销部分 股票期权的公告

有研半导体硅材料股份公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股票期权拟行权数量,268.08万份

● 行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次 会议,审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年 股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计 划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》,根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票 期权激励计划(草案)》的相关规定,2024年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予第一 个行权期的行权条件已经成就。现将有关事项说明fm下,

一、股权激励计划批准及实施情况.

(一)股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024年9月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于《有研半导体硅材料股份公 司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期 权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议 通过。

同日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于《有研半导体硅材料股份公司2024年股 票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<有研半导体硅材料股份公司2024股票期权激励计 划首次授予部分激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核

2、2024年9月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股 份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-040),独立董事袁少颖受其他独 立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行 了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公 司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-

4、2024年9月27日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于《有研半导体硅材料股 份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年 股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授 予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2024-043)。 6、2024年10月10日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《乡 于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予 条件已经成就,同意以2024年10月10日为授予日,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上 述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对 象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com en)披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的公告》(公告编号:2024-047)及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部

5、2024年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股

分激励对象名单(截止授予日)》。 7、2024年10月24日,公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首 次授予完成登记的公告》(公告编号: 2024-048),公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成授予登记手续,向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的iV家》。董事会i人为本激励计划授予 预留部分期权的条件已经成就,同意以2025年3月14日为授予日,以9.11元/份的行权价格向34名激 励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审 议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和 职条进行了公元 公元期共10天 在公元期内 公司监事会老协到任何对本次遵局计划遵局对象提 出的异议。具体内容详见公司于2025年03月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于 公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》

10、2025年4月23日,公司披露了《有研硅关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公 告》,股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日,股票期权预留授予登记数量为90.00万份,股

票期权预留授予登记人数为34人 11、2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年 股票期权激励计划行权价格的议案》,根据2024年第二次临时股东大会的授权,对2024年股票期权激 励计划行权价格进行相应调整,行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时,第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年 股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票 期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达 到目标值,公司层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成 Λ 导致不能完全行权, 公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票 期权,本次实际可行权激励对象为92名,行权数量为268.08万份,行权价格为9.05元/股。薪酬和考核 委员会发表了明确同意的意见。

(二)本激励计划首次授予股票期权情况 公司于2024年10月10日向92名激励对象授予1 145 00万份股票期权

序号	項目 2024年股票期权激励计划内容		
1	股票期权授予日	2024年10月10日	
2	股票期权首次授予登记完成日	2024年10月23日	
3	等待期	本次股权激励计划首次授予的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为自首次 接予日起12 个月、34个月、36个月。简简接予的股票期权的等待期分别为自预馆 接予日起12 个月、24个月、36个月。等待期内、涨断对象获授的股票期权不得料 让、用于短快或跨还债务。	
4	授予价格	9.11元/份	
5	授予数量	1,145.00万份	
6	授予人数	92人	
7	授予后股票期权剩余数量	90万份	

(三) 历次激励对象人数、期权数量、行权价调整情况 鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值 公司层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权,公司及个人 考核不达标部分的股票期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权,本次 实际可行权激励对象为92名,行权数量为268.08万份。公司于同日披露了《关于调整公司2024年股 票期权激励计划行权价格的公告》,因2024年度利润分配方案实施完毕,公司董事会根据2024年第二 次临时股东大会的授权,对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整,经过本次调整后,行权 价格由9.11元/股调整为9.05元/股。

(四)各期股票期权行权情况 本次行权为2024年股票期权激励计划首次授予部分第一期行权。

、股票期权行权条件说明

(一)董事会就股权激励计划设定的股票期权行权条件成就的审议情况 2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果。 审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期 权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次 P.授予但未获准行权的股票期权的议案》。关联董事方永、

薪酬和考核委员会认为:公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权期的行权条 件已经成就,同意公司为符合行权条件的92名激励对象办理股票期权行权事宜,本次可行权数量为 268.08 万股。本事顶符会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损 害公司及股东利益的情形。因此,董事会薪酬和考核委员会同意本次行权事项。

(二)本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件 本激励计划股票期权首次授予部分的授予日为2024年10月10日,本次股权激励计划首次授予 的股票期权公二次行权 第一个行权期白授予日起12个日后的首个交易日起至授予日起24个日内的 最后一个交易日当日止。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。本激 励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件已成就,等待期已于2025年10月10日届满。

7公司不及主知下证一情形: 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的F 駅以上「ブルドルのアンス) 告: 設近一个会計年度財务报告内部控制被注册会計師出具否定意见或者无法表示意见的 厳至目前,公司未发生左述情形,满足和 郎託行な条件。 报告; :市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

激励对象获授的股票期权需同时满足以下行权条件方可办理行权事宜:

D激励对象来发生如下任一情形; 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 最近12个月内被正司正监会发长据出机构认定为不适当人选; 最近12个月内国重大法法连照行为被中国证监会及共派出机构行政处罚或者采取市场 战至目前,激励对象未发生左述情形, 足本项行权条件。 人措施: 为书记在人运在公司为第十日正正安及中枢目的与 人措施: 具有公司法)规定的不得担任公司能可决定的辩论: 法律法规规定: 中国证监会认定的其他情形。 自殺折旧擁销前利润(EBITDA 行权期 业绩考核年度 触发值(An) 2024年 4.2亿元 4.8亿元 4.2亿元 024年度财务报表及审计报告》(4 024年EBITDA为4.11亿元,达到制

名激励对象的年度绩效考核结果 b"B",满足本项可 综上所述,公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已经成

就,本次符合行权条件的激励对象共计92名,可行权数量268.08万份,占获授股票期权数量比例为 23.41%,占公司总股本约为0.21%。 (三)未达到行权条件的股票期权的处理方法

鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值, 公司层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权,公司及个人 考核不达标部分的股票期权合计75.42万份,公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。 三、本次行权的具体情况

1、授予日:2024年10月10日 2、行权数量:268.08万份

3、行权人数:92人 4、行权价格:9.05元/份(调整后)

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6、行权方式:批量行权 7、行权安排:自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交

易日当日止,为2024年股票期权激励计划的首次授予部分的第一个行权期。公司管理层将根据相关 注律法规的规定确定行权期,统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关行权股份答 记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行 权日,同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他相关手续。激励对象所持有的本次可行权的股票 期权须在公司确定的行权窗口期内行权完毕;行权窗口期届满,当期未行权的股票期权不得再行权或 递延至下一行权期,由公司予以注销。

8、激励对象名单及可行权情况

野舎 製造 野舎 野漁 野龍(万谷) 明邦収数量的比例(%) - 本事、高数管理人員、 たし技术人員 1 万永又 雍単紀 2 孫県東 雍明 北京 2 孫県東 32 76,800,000 24 2 孫県東 32 76,800,000 24 4 4 4								
1 方永义 董昭长 40 96,000,00 24 2 死果虎 董郎を管理 40 96,000,00 24 3 刘斌 董位於理 32 76,800,00 24 4 杨波 財务总監 靈秘 32 76,800,00 24 5 同志團 杨心技术人员 32 61,440,00 19.2 6 子權后 私心技术人员 27 64,800,00 24 7 吳志國 杨心技术人员 22 52,800,00 24 8 宁水榉 他人技术人员 22 52,200,00 24 一、核心业务人员及董事会认方需要激励的其他人员供 898 2,103,360,00 23,42	序号	姓名	取代分子	数量(万份)	可行权数量(份)	可行权数量占已获授予股 票期权数量的比例(%)		
2 新果康 董事に終理 40 96,000.00 24 3 対策 副位約罪 32 76,900.00 24 4 核破 財务总監、董秘 32 76,900.00 24 5 同志署 核心技术人所 32 61,440.00 19.2 6 予報任 核心技术人所 27 64,800.00 24 7 吳公園 核心技术人所 22 52,800.00 24 8 宁水肾<		一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
3 対策 間急影理 32 76,800,00 24 4	1	方永义	董事长	40	96,000.00	24		
4 極皮 財务会監査総 32 76,800.00 24 5 国志階 株心技术人员 32 61,440.00 19.2 6 李耀宗 株心技术人员 27 64,800.00 24 7 及必需 株心技术人员 22 52,800.00 24 米の子外等 株心技术人员 22 52,800.00 24 二、核心业务人员及董事会认为需要撤销的其他人员(共 898 2,103,360.00 23,42	2		董事、总经理	40	96,000.00	24		
5 同志開 核心技术人员 32 61,440,00 19.2 6 子報左 株心技术人员 27 64,800,00 24 7 泉志園 株心技术人员 22 52,800,00 24 8 宁水幹 株心技术人员 22 52,200,00 24 二、核心业务人员及审专处方需要撤销的其他人员供 898 2,103,360,00 23,42	3	刘斌	副总经理	32	76,800.00	24		
6 李耀蕉 核心技术人员 27 64,800.00 24 7 艮志總 核心技术人员 22 52,800.00 24 8 宁永铎 核心技术人员 22 52,800.00 24 二、核心业务人员及董事会认为需要最短的其他人员(共 84人) 84人) 88人) 2,103,360.00 23,42	4	杨波	财务总监、董秘	32	76,800.00	24		
7	5	闫志瑞	核心技术人员	32	61,440.00	19.2		
8	6			27	64,800.00	24		
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员(共 84人) 898 2,103,360.00 23.42	7							
84人) 898 2,103,360.00 23.42					52,800.00	24		
1145 2 (80 800 00 22 41			898	2,103,360.00	23.42			
日本 1145 2,080,800.00 25.41	合计		1145	2,680,800.00	23.41			

注1: 上述激励对象不包括独立董事、监事。

注2:以上被激励的高级管理人员,均已经董事会聘任。

注3:以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情 况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工

注4:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 四. 本次注销股票期权的情况

鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值, 层面可行权比例为80%,部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权,公司及个人 **老核不达标部分的股票期权会计75.42** 万份,根据《有研坐导休硅材料股份公司 2024 年股票期权衡 励计划(草案)》相关规定,公司将注销该部分已授予但考核不达标的股票期权合计75.42万份。 五、董事会薪酬和考核委员会对激励对象名单的核实情况 公司董事会薪酬和考核委员会对激励对象名单进行核查后,认为公司2024年股票期权激励计划

首次授予部分的第一个行权期的行权条件已经成就,同意公司为符合行权条件的92名激励对象办理 股票期权行权事宜,本次可行权数量为268.08万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海

激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 六、行权日及买卖公司股票情况的说明 公司管理层将根据相关法律法规的规定确定行权期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的 归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当

证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权

日确定为行权日。实际可行权期限根据批量行权手续办理情况确定。

经核查,参与本次行权的董事、高级管理人员在此前6个月内不存在买卖公司股票的情况。 七、股票期权费用的核算及说明 公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计

费用进行相应摊销,计入相关成本或费用和资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本 和股本溢价,本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 八、法律意见书的结论性意见 北京德恒律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司2024年股票期权激励计划调整行权 价格、首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权;

量》,企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来

计算股票期权的公允价值, 授予日后 公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-040

有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

● 股东会召开日期:2025年11月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

召开地点:北京市西城区新街口外大街2号有研大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年11月12日

的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项

非累积投票议案 关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

券日报》《经济参考报》予以披露。 公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年第三次临时股

4 涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他人员

(二)登记手续

五、会议登记方法 (一)现场出席会议的预约登记 拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约 po@gritek.com 进行预约登记;信函预约的以收到邮戳为准,信函上请注明"股东会"字样;为避免信息

登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以

1、自然人股东:本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明(身份证件)、股票账户

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

加盖公章); 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授 权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1)。

时到达会议现场办理登记手续。 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕

参与投票表决。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不 能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承扣。

六、其他事项

地址:北京市西城区新街口外大街2号D座17层 邮编:100088

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年10月28日

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

、司本次股票期权激励计划调整行权价格、本次行权条件的成就及本次注销符合《管理办法》《激励计 划(草案)》的相关规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续,并履行相应的信息披露义务。

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月12日 14点00分

至2025年11月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

本次股东会审议议案及投票股东类型

木次想交股东会审议的iV案已经公司第二届董事会第十一次会iV审iV通过 相关公告已干2025 年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

席股东令(具体情况详见下表)。并可以以书面形式委托代理人出席令议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

的请于2025年11月10日17时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 griteki-

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书 原件(授权委托书格式请见附件1); 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执昭(复印件并

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,现场参会人员建议至少提前半小

参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。 (二)会议联系方式

联系人,孙姆 电话:010-82087088 电子邮箱:gritekipo@gritek.com 特此公告。

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年 第三次临时股东会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称 关于调整部分募投项目实施方案暨部分慕投项曰延距

委托日期: 年月日 备注:

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。